

2022-2028年中国集成电路 市场前景展望与投资可行性报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2022-2028年中国集成电路市场前景展望与投资可行性报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/998477TD33.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

集成电路是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比（基于锗（Ge）的集成电路）和罗伯特·诺伊思（基于硅（Si）的集成电路）。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。

智研数据研究中心发布的《2022-2028年中国集成电路市场前景展望与投资可行性报告》共九章。首先介绍了集成电路行业市场发展环境、集成电路整体运行态势等，接着分析了集成电路行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路市场竞争格局。随后，报告对集成电路做了重点企业经营状况分析，最后分析了集成电路行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资集成电路行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：中国集成电路行业发展分析

1.1 集成电路行业发展综述

1.1.1 集成电路行业统计标准

1.1.2 集成电路行业周期性

1.2 集成电路行业发展环境分析

1.2.1 集成电路行业政策环境分析

（1）行业管理体制

（2）行业相关政策及规划

（3）政策环境对行业发展的影响

1.2.2 集成电路行业经济环境分析

（1）国际经济环境现状与前景预测

（2）中国经济环境现状与前景预测

(3) 经济环境对行业发展的影响

1.2.3 集成电路行业技术环境分析

(1) 行业技术专利情况

(2) 行业总体技术水平分析

(3) 技术环境对行业发展的影响

1.3 集成电路行业发展机遇和挑战

1.3.1 集成电路产业面临的发展机遇

(1) 新兴领域需求提升，持续开拓市场空间

(2) 集成电路行业将向发展中国家进行迁移

(3) 芯片国产化和政策助力中国半导体发展

1.3.2 集成电路行业面临的挑战

(1) 对进口产品仍有较大依赖性

(2) 技术能力不强

(3) 在产业格局中处于边缘

第2章：中国集成电路行业发展现状及产业链分析

2.1 集成电路行业发展现状分析

2.1.1 全球集成电路行业发展现状

(1) 行业需求稳健成长

(2) 美国一家独大，亚太地区快速发展

2.1.2 中国集成电路行业发展现状分析

(1) 行业经济指标分析

(2) 行业结构分析

2.1.3 行业总体竞争力分析

(1) 我国集成电路产业逆势增长

(2) 封测龙头跻身全球第三

2.1.4 集成电路行业进出口分析

2.2 集成电路行业发展现状分析

2.2.1 集成电路行业产业链简介

2.2.2 集成电路行业材料供给分析

(1) 国际硅材料供应现状

(2) 国内集成电路生产材料供应现状

2.2.3 集成电路生产设备供给分析

- (1) 国内集成电路装备制造业政策分析
- (2) 国内集成电路装备制造业现状分析
- (3) 国内集成电路装备制造业问题分析

2.3 集成电路设计业发展分析

2.3.1 集成电路设计业发展概况分析

2.3.2 集成电路设计业市场规模分析

2.3.3 集成电路设计业市场特征分析

- (1) 技术能力大幅提升
- (2) 行业发展仍存隐忧

2.3.4 集成电路设计业竞争格局分析

2.3.5 集成电路设计业发展策略分析

2.3.6 集成电路设计业发展前景预测

2.4 集成电路制造行业发展分析

2.4.1 集成电路制造行业发展现状分析

- (1) 集成电路制造行业发展总体概况
- (2) 集成电路制造行业发展主要特点
- (3) 集成电路制造行业主要经济效益影响因素

2.4.2 集成电路制造所属行业规模及财务指标分析

- (1) 集成电路制造所属行业规模分析
- (2) 集成电路制造所属行业盈利能力分析
- (3) 集成电路制造所属行业运营能力分析
- (4) 集成电路制造所属行业偿债能力分析
- (5) 集成电路制造所属行业发展能力分析

2.4.3 集成电路制造行业供需平衡分析

- (1) 集成电路制造行业供给情况分析
- (2) 集成电路制造行业需求情况分析
- (3) 全国集成电路制造所属行业产销情况分析

2.4.4 集成电路制造行业发展前景预测

2.5 集成电路封装测试业发展分析

2.5.1 集成电路封测业市场规模分析

2.5.2 集成电路封测业经营情况分析

(1) 集成电路行业与半导体行业发展况密切相关

(2) 行业创新水平影响行业利润率

(3) 行业发展稳定

2.5.3 国内外厂商技术水平对比分析

2.5.4 集成电路封测业竞争格局分析

(1) 国内集成电路封测业竞争格局分析

(2) 国内集成电路封测企业国际竞争力分析

(3) 集成电路封装测试业竞争结构波特五力模型分析

2.5.5 集成电路封测业发展趋势分析

(1) 封装技术发展趋势

(2) 应用领域发展趋势

2.5.6 集成电路封测业发展前景预测

(1) 上游产业前景巨大

(2) 下游市场需求旺盛

第3章：中国集成电路细分产品市场需求分析

3.1 IC卡市场需求分析

3.1.1 IC卡市场需求现状分析

3.1.2 IC卡市场需求规模分析

3.1.3 IC卡市场竞争格局分析

(1) 市场占有率分析

(2) 各企业竞争优势分析

3.1.4 IC卡市场需求前景预测

3.2 计算机市场需求分析

3.2.1 计算机市场需求现状分析

3.2.2 计算机市场供给规模分析

3.2.3 计算机市场需求规模分析

3.2.4 计算机市场经营效益分析

3.2.5 计算机市场竞争格局分析

(1) 产品竞争格局分析

(2) 重点企业竞争格局分析

3.2.6 计算机市场发展趋势预测

- (1) PC市场结构调整，用户数量将下降
- (2) 智能化趋势提供新的机遇
- (3) 游戏本发展迅猛
- (4) 国产化替代浪潮加速

3.3 无线通信设备市场需求分析

3.3.1 无线通信设备市场需求现状分析

3.3.2 无线通信设备市场供给规模分析

3.3.3 无线通信设备市场需求规模分析

3.3.4 无线通信设备市场竞争格局分析

3.3.5 无线通信设备市场需求前景预测

(1) 全球市场预测

(2) 国内市场预测

3.4 其他消费类电子产品市场需求分析

3.4.1 其他消费类电子产品需求现状分析

3.4.2 其他消费类电子产品需求规模分析

3.4.3 其他消费类电子产品竞争格局分析

(1) 数码相机竞争格局分析

(2) 平板电视竞争格局分析

(3) 智能穿戴设备竞争格局分析

3.5 微控制单元（MCU）市场需求分析

3.5.1 MCU市场需求现状分析

3.5.2 MCU市场需求规模分析

3.5.3 MCU市场竞争格局分析

(1) MCU市场整体竞争格局

(2) MCU细分市场竞争格局

3.5.4 MCU市场需求前景预测

第4章：中国集成电路芯片市场需求分析

4.1 SIM芯片市场需求分析

4.1.1 SIM芯片发展现状分析

4.1.2 SIM芯片需求规模分析

(1) SIM芯片整体出货量

(2) NFC类SIM卡出货量

(3) LTE类SIM卡出货量

4.1.3 SIM芯片竞争格局分析

4.1.4 SIM芯片需求前景预测

4.2 移动支付芯片市场需求分析

4.2.1 移动支付芯片发展现状分析

(1) 移动支付产品分析

(2) 银联与中移动移动支付标准之争已经解决

(3) 已有大量POS机支持NFC功能

(4) 国内供应商开始发力NFC芯片

4.2.2 移动支付芯片需求规模分析

4.2.3 移动支付芯片竞争格局分析

4.2.4 移动支付芯片需求前景预测

4.3 身份识别类芯片市场需求分析

4.3.1 身份识别类芯片发展现状分析

(1) 身份识别介绍

(2) 身份识别分类

4.3.2 身份识别类芯片需求规模分析

4.3.3 身份识别类芯片竞争格局分析

4.3.4 身份识别类芯片存在问题

(1) 缺乏自主知识产权

(2) 安全性尚待加强

(3) 应用尚待开发

(4) 解决方案仍在探索

4.3.5 身份识别类芯片需求前景预测

4.4 金融支付类芯片市场需求分析

4.4.1 金融支付类芯片发展现状分析

(1) 标准体系建设

(2) 受理环境建设

(3) 卡片发行工作

4.4.2 金融支付类芯片需求规模分析

4.4.3 金融支付类芯片竞争格局分析

4.4.4 金融支付类芯片需求前景预测

4.5 USB-KEY芯片市场需求分析

4.5.1 USB-KEY芯片发展现状分析

4.5.2 USB-KEY芯片需求规模分析

4.5.3 USB-KEY芯片竞争格局分析

4.5.4 USB-KEY芯片需求前景预测

4.6 通讯射频芯片市场需求分析

4.6.1 通讯射频芯片发展现状分析

4.6.2 通讯射频芯片需求规模分析

4.6.3 通讯射频芯片竞争格局分析

4.6.4 通讯射频芯片需求前景预测

4.7 通讯基带芯片市场需求分析

4.7.1 通讯基带发展现状分析

4.7.2 通讯基带芯片需求规模分析

4.7.3 通讯基带芯片竞争格局分析

(1) 国际厂商竞争格局分析

(2) 国内厂商竞争格局分析

4.7.4 通讯基带芯片需求前景预测

(1) 基带和应用处理器融合加深

(2) 价格战将加剧

(3) 工艺决定竞争力

4.8 家电控制芯片市场需求分析

4.8.1 家电控制芯片发展现状分析

4.8.2 家电控制芯片需求规模分析

4.8.3 家电控制芯片竞争格局分析

4.8.4 家电控制芯片需求前景预测

4.9 节能应用类芯片市场需求分析

4.9.1 节能应用类芯片发展现状分析

4.9.2 节能应用类芯片需求规模分析

4.9.3 节能应用类芯片竞争格局分析

4.9.4 节能应用类芯片需求前景预测

4.10 电脑数码类芯片市场需求分析

- 4.10.1 电脑数码类芯片发展现状分析
- 4.10.2 电脑数码类芯片需求规模分析
- 4.10.3 电脑数码类芯片竞争格局分析
- 4.10.4 电脑数码类芯片需求前景预测

第5章：中国集成电路下游市场需求分析

5.1 计算机行业对集成电路需求分析

5.1.1 计算机行业发展现状分析

5.1.2 计算机对集成电路需求分析

5.2 手机行业对集成电路需求分析

5.2.1 手机行业发展现状分析

5.2.2 手机对集成电路需求分析

5.3 可穿戴设备行业对集成电路需求分析

5.3.1 可穿戴设备行业发展现状分析

5.3.2 可穿戴设备行业对集成电路需求分析

5.4 工业控制行业对集成电路需求分析

5.4.1 工业控制行业发展现状分析

(1) 工业机器人发展现状

(2) 变频器发展现状

(3) 传感器发展现状

(4) 工控机发展现状

(5) 机器视觉发展现状

(6) 3D打印发展现状

(7) 运动控制器发展现状

5.4.2 工业控制对集成电路需求现状

5.5 汽车电子行业对集成电路需求分析

5.5.1 汽车电子行业发展现状分析

5.5.2 汽车电子对集成电路需求现状

5.5.3 汽车电子对集成电路需求前景

第6章：主要集成电路行业竞争主体发展分析

6.1 外商独资企业发展分析

6.1.1 外商独资企业发展现状分析

6.1.2 外商独资企业市场份额分析

6.1.3 外商独资企业经营情况分析

6.1.4 外商独资企业投资并购分析

6.1.5 外商独资企业发展战略分析

(1) 与中国企业组建合资公司

(2) 与中国企业开展单产品合作

6.1.6 外商独资企业竞争优势分析

6.1.7 前瞻对外商独资企业发展建议

6.2 中外合资企业发展分析

6.2.1 中外合资企业发展现状分析

6.2.2 中外合资企业市场份额分析

6.2.3 中外合资企业经营情况分析

6.2.4 中外合资企业投资并购分析

6.2.5 中外合资企业发展战略分析

6.2.6 中外合资企业竞争优势分析

6.2.7 中外合资企业存在问题分析

6.2.8 中外合资企业最新动向分析

6.2.9 前瞻对中外合资企业发展建议

6.3 内资企业发展分析

6.3.1 内资企业发展现状分析

6.3.2 内资企业市场份额分析

6.3.3 内资企业经营情况分析

6.3.4 内资企业扶持政策分析

6.3.5 内资企业投资并购分析

6.3.6 内资企业发展战略分析

(1) 加强公司内控体系建设，保障公司规范化运作

(2) 提高研发成果向新产品转化的速度，以创新促效益

(3) 强化市场管理机制，优化市场销售策略

(4) 加强项目管理，提高经营效率

(5) 强化以人为本的用人理念，建立科学的人才机制

6.3.7 内资企业竞争优势分析

6.3.8 内资企业存在问题分析

6.3.9 内资企业最新动向分析

6.3.10 国内市场进口替代空间分析

6.3.11 前瞻对内资企业发展建议

第7章：重点区域集成电路产业发展分析

7.1 集成电路行业区域发展格局分析

7.1.1 国内集成电路行业区域发展现状

(1) 长三角地区

(2) 环渤海地区

(3) 珠三角地区

7.1.2 国内集成电路行业整体分布格局

(1) 整体呈现“一轴一带”的分布特征

(2) 产业整体将“有聚有分，东进西移”

7.2 长三角地区集成电路产业发展分析

7.2.1 集成电路产业发展概况

7.2.2 集成电路产业政策规划分析

(1) 上海市集成电路行业政策规划分析

(2) 无锡市集成电路政策规划分析

(3) 苏州市集成电路政策规划分析

(4) 杭州市集成电路政策规划分析

7.2.3 集成电路设计业发展分析

(1) 无锡

(2) 上海

7.2.4 集成电路制造业发展分析

7.2.5 集成电路封装测试业发展分析

7.2.6 集成电路产业发展前景预测

7.3 京津环渤海地区集成电路产业发展分析

7.3.1 集成电路产业发展概况

7.3.2 集成电路产业政策规划分析

7.3.3 集成电路设计业发展分析

(1) 北京

(2) 天津

(3) 山东

(4) 辽宁

7.3.4 集成电路制造业发展分析

7.3.5 集成电路封装测试业发展分析

7.3.6 集成电路产业发展前景预测

7.4 泛珠三角地区集成电路产业发展分析

7.4.1 集成电路产业发展概况

7.4.2 集成电路产业政策规划分析

7.4.3 集成电路产业配套发展分析

7.4.4 集成电路设计业发展分析

(1) 广东省

(2) 福建省

7.4.5 集成电路制造业发展分析

7.4.6 集成电路封装测试业发展分析

7.4.7 集成电路产业发展前景预测

7.5 其他重点地区集成电路产业发展分析

7.5.1 重庆市集成电路产业发展分析

7.5.2 四川省集成电路产业发展分析

7.5.3 西安市集成电路产业发展分析

7.5.4 湖北省集成电路产业发展分析

(1) 政策扶持产业发展

(2) 基金推动产业升级

(3) 科教奠定人才基础

(4) 产业链已基本形成

第8章：集成电路重点企业发展分析

8.1 集成电路综合型企业发展分析

8.1.1 武汉光迅科技股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.1.2 大唐电信科技股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.1.3 杭州士兰微电子股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.1.4 国民技术股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.1.5 紫光国芯微电子股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.2 集成电路设计企业发展分析

8.2.1 紫光股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.2.2 深圳海思半导体有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.2.3 中颖电子股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.3 集成电路制造企业发展分析

8.3.1 中芯国际集成电路制造有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析

8.3.2 和舰科技（苏州）有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析

8.3.3 上海先进半导体制造股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析

8.4 集成电路封装测试企业发展分析

8.4.1 日月光封装测试（上海）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.4.2 江苏长电科技股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

8.4.3 苏州晶方半导体科技股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

8.4.4 天水华天科技股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

8.4.5 通富微电子股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

第9章：集成电路行业投资战略规划与建议()

9.1 集成电路行业市场前景预测

9.1.1 集成电路行业市场规模预测

9.1.2 集成电路行业供给规模预测

9.1.3 集成电路行业发展趋势分析

(1) 集成电路行业区域发展趋势

(2) 集成电路行业技术发展趋势

(3) 集成电路行业产品结构趋势

(4) 集成电路行业市场竞争趋势

9.2 集成电路行业投资前景分析

9.2.1 集成电路行业发展的影响因素分析

(1) 有利因素

(2) 不利因素

9.2.2 集成电路行业进入壁垒分析

(1) 技术壁垒

(2) 人才壁垒

(3) 资金实力壁垒

(4) 产业化壁垒

(5) 客户维护壁垒

9.2.3 集成电路行业投资风险分析

(1) 政策风险

(2) 宏观经济风险

(3) 供求风险

(4) 其他风险

9.2.4 集成电路行业投资前景分析

(1) 行业发展空间较大

(2) 行业政策扶持利好

(3) 下游应用市场增长迅速

9.3 集成电路行业投资机会与建议

9.3.1 前瞻关于集成电路行业投资热点分析

(1) 集成电路设计业被看好

(2) 网络通信领域依然是核心

(3) 智能家居等市场集成电路需求强劲

(4) 小型化和立体化封装技术具有发展潜力

9.3.2 前瞻关于集成电路行业投资机会分析

9.3.3 前瞻关于集成电路细分市场投资建议

9.3.4 前瞻关于集成电路区域布局投资建议

9.3.5 前瞻关于集成电路企业并购重组建议()

图表目录：

图表1：集成电路行业代码表

图表2：摩尔定律和计算机芯片发展示意图（单位：个）

图表3：截至2020年集成电路行业主要政策分析

图表4：2016-2020年美国国内生产总值变化趋势图（单位：十亿美元，%）

图表5：2016-2020年欧元区GDP季度同比增长变化（单位：%）

图表6：2016-2020年日本GDP同比变化（单位：%）

图表7：2022-2028年世界银行和IMF对全球主要经济体经济增速预测（单位：%）

图表8：2016-2020年世界GDP与集成电路市场增长相关关系

图表9：2016-2020年我国国内生产总值及变化趋势（单位：亿元，%）

图表10：2016-2020年我国全部工业增加值及增速（单位：亿元，%）

图表11：2016-2020年中国农村居民人均可支配收入及增长趋势图（单位：元，%）

图表12：2016-2020年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图（单位：元，%）

图表13：受疫情影响2021年GDP增长预测（单位：%）

图表14：2016-2020年国内集成电路行业发明专利申请数量变化图（单位：项）

图表15：2016-2020年集成电路行业专利公开数量变化图（单位：项）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/998477TD33.html>